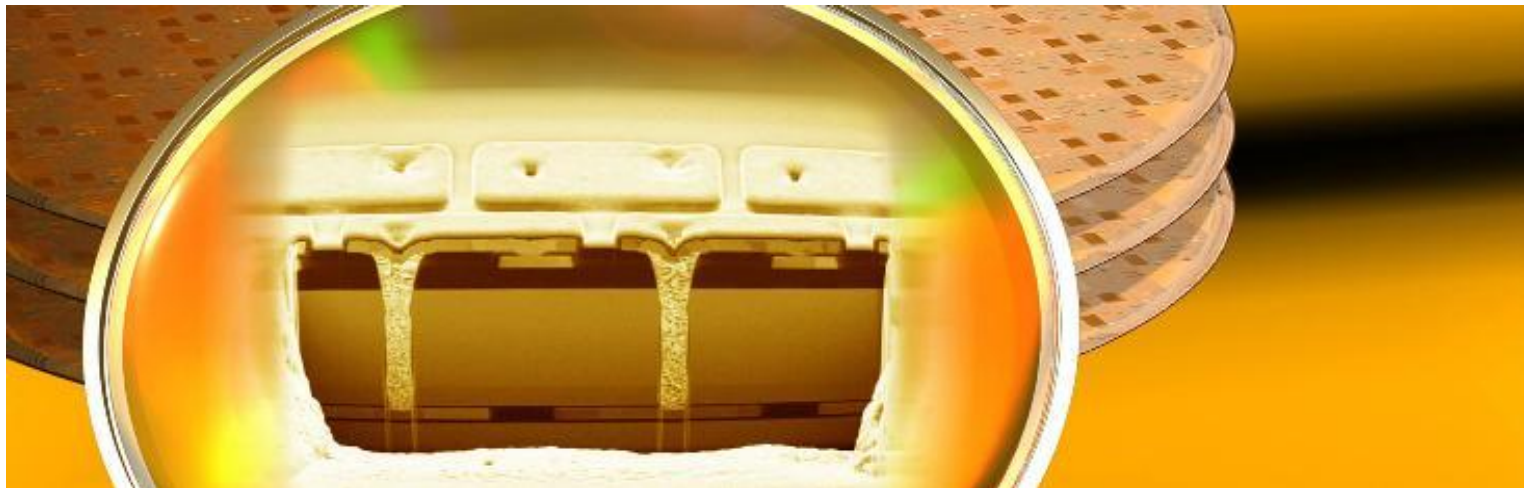


3D異種統合

5 μ mまでの微細ピッチに対応した高密度な相互接続技術を実現しており、TSVフリーアーキテクチャを採用することで、コスト効率に優れた製造オプションを提供しています。

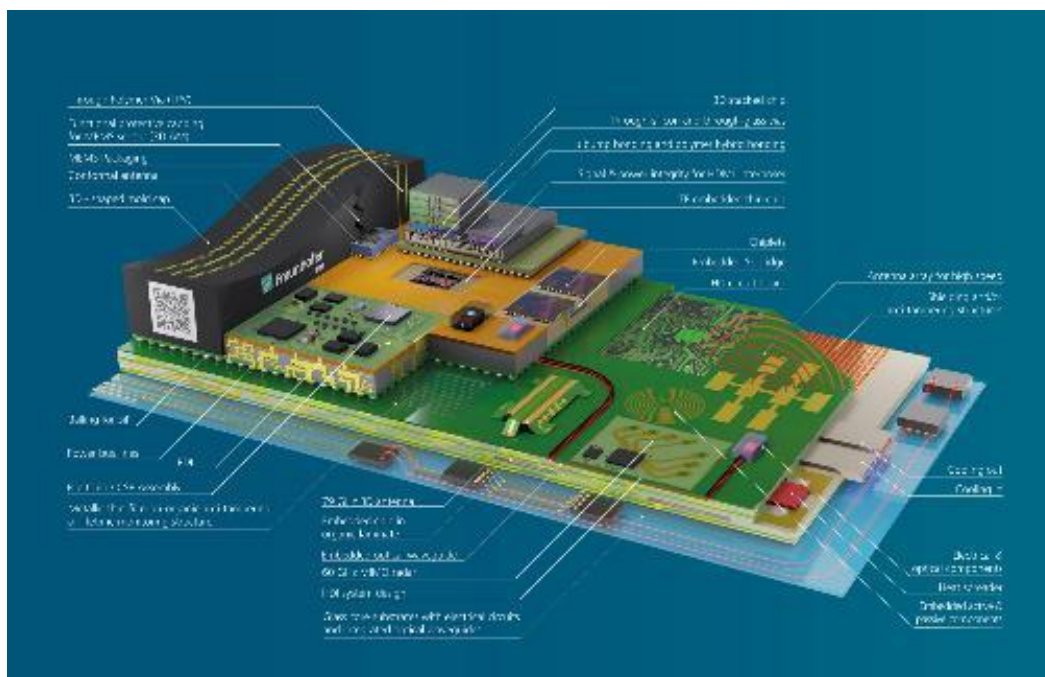
単一のプロセスで機械的接合と電氣的接続を同時に実現できるため、工程の簡素化と高い信頼性の両立が可能です。さらに、ウェハレベルおよびダイレベルにおいてCMOSとMEMSの共集積に対応しており、高度なシステムインテグレーションを実現します。





異種統合

インターポザーの構築、チップの積層、MEMSのシステムへの統合において卓越した技術を有しています。冷却、アンテナ、データ伝送機能も担当し、これらの革新的な技術を設計ガイドラインに落とし込み、その信頼性を保証





機械式穴あけ、レーザー穴あけ、X線検査、機械加工、内層パンチ



OREL TECH

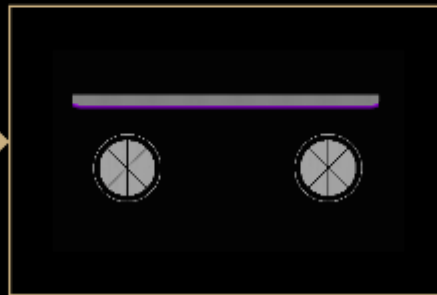
印刷可能なフレキシブルセンサーから触媒表面、医療グレードのコーティングまで、OREL TECHの金属化液と硬化技術は、表面に機能性を付与し、貴金属が必要とされるあらゆる場所で持続可能かつ費用対効果の高いソリューションを提供

OREL TECHの技術は、金属コーティングの簡単、直接、迅速な成膜を可能にします。OTechの導電性インクとめっき液は、安全な低温プラズマ技術で硬化され、化学廃棄物を一切残しません。
当社の技術は、以下の2つの簡単なステップで構成されています。

ステップ1：印刷／コーティング



ステップ2：プラズマ硬化



純金属層





SMD(表面実装デバイス)フィルムセンサー、ストライプフィルムセンサーと
SMDフィルムセンサーの幅広いラインナップ 開発と量産

